

Page 1 of 6

新闻稿

实时发布

香港科技园公司与黑芝麻智能签署合作备忘录 推动香港智能汽车产业发展 促进微电子升级研发

计划于香港科学园设立科技创新研发中心 作为国际总部并加大科研及人员投入

- 科技园公司与黑芝麻智能的合作，是由创新科技及工业局和引进重点企业办公室共同策动，以推动本地智能汽车产业发展，促进微电子升级研发。
- 科技园公司与黑芝麻智能签署合作备忘录，合力推动「黑芝麻智能香港科技创新研发中心」于香港科学园落户，在园区内打造车规级高性能智能汽车计算芯片平台，协助香港建立完整的全球芯片供应链。
- 黑芝麻智能 2027 年底前的总投资额约为 1 亿美元，预计在香港扩充团队至 100 位研发人员。

(香港，2023 年 11 月 6 日) – 香港科技园公司 (科技园公司) 与黑芝麻智能科技有限公司 (黑芝麻智能) 今日签署合作备忘录，宣布在香港科学园内设立「黑芝麻智能香港科技创新研发中心」，携手打造车规级高性能智能汽车计算芯片平台，以推动香港的汽车芯片产业及微电子生态圈发展。

是次科技园公司与黑芝麻智能的合作由创新科技及工业局和引进重点企业办公室共同策动，以推动本地智能汽车产业发展，促进微电子升级研发。在创新科技及工业局局长孙东教授、创新科技及工业局副局长张曼莉女士、引进重点企业办公室副主任范伟明先生、香港科技园公司行政总裁黄克强先生及黑芝麻智能科技有限公司创始人兼行政总裁单记章先生见证下，香港科技园公司首席企业发展总监姚庆良博士工程师与黑芝麻智能科技有限公司首席市场营销官杨宇欣先生签署合作备忘录。

在是次合作框架下，黑芝麻智能会将位于香港科学园的「黑芝麻智能香港科技创新研发中心」打造成高性能车规级芯片研发中心，并持续进行研发投入，预计于 2027 年底前投入共一亿美元，并将本地研发团队扩充至 100 人。

Page 2 of 6

创新科技及工业局局长孙东教授表示：「黑芝麻智能落户香港是用实际行动对香港创科投下信心的一票。连同早前已经落户的新能源及智能汽车企业，黑芝麻智能可与各同业者同行一起在本地和这个领域构造生态圈，并有效联结海内外产业链，加强香港在新能源汽车领域的竞争力，促进香港整体科技产业的发展。这些企业亦将有助吸引更多海内外的科技和研发人才来港，而且协助提升本地人才的技能和科技积累。」

香港科技园公司行政总裁黄克强先生表示：「黑芝麻智能落户科学园，是对香港创科实力的充分肯定。微电子产业是国家重点新兴产业之一，而香港具备独特优势，非常适合发展微电子产业、带动创新产品的应用。科技园公司将与黑芝麻智能携手推动香港高端芯片产业发展，同时和其他公司、大学和科研机构紧密交流，培育及吸纳更多微电子专才，为香港建立完整的全球芯片供应链和微电子人才技术枢纽。」

黑芝麻智能科技有限公司创始人兼行政总裁单记章先生表示：「香港具有区位、政策支持、科研等多方面的优势，与科技园公司的合作对于黑芝麻智能意义重大。一方面，我们将与科技园公司共同为实现香港创新科技的目标提供助力，为我国智能汽车产业的发展做出贡献。同时，黑芝麻智能立足全球，香港是我们全球化战略布局的重要组成部分，将为我们搭建连接世界、服务全球的桥梁，黑芝麻智能将以此作为立足点，全力赋能全球智能驾驶产业的创新。」

去年公布的《香港创科发展蓝图》明确支持先进制造产业发展，例如半导体芯片。2023 年施政报告又宣布成立「香港微电子研究院」，引领和促进大学、研发中心和业界合作，包括研究第三代半导体核心技术，利用大湾区内完备的制造业产业链和庞大的市场，进一步为微电子产业构建一个更有利的发展环境。

黑芝麻智能是瞩目的车规级智能汽车计算芯片及基于芯片的解决方案供货商，一直致力推进先进制程高性能车规芯片产能的应用。黑芝麻智能的团队拥有 20 年以上的汽车芯片领域从业经验，其独有的车规级产品及技术，为智能汽车配备关键任务能力，包括自动驾驶、智能座舱、先进成像及互联等。黑芝麻智能利用自主研发的 IP 核和算法、支持软件驱动的 SoC (System on Chip，即「系统单芯片」)，以及基于 SoC 的解决方案，提供全栈式自动驾驶能力，以满足客户的广泛需求。

科技园公司一直致力推动香港的「新型工业化」进程，打造世界领先的微电子生态圈。现时科技园公司已建设完善的微电子硬件设施，包括传感器封装集成实验室 (Sensor Lab)、异构系

Page 3 of 6

统整合实验室（HI Lab）及硬件实验室（Hardware Lab），这些设施能支持芯片相关的设备和系统以至产品的设计、原型制作及试点生产的完整流程。位于元朗创新园的微电子中心将于2024年启用，将配合科技园公司多项基础建设，加速微电子研发及中试，为上下游企业及产业链创造机遇。

科技园公司的微电子生态圈发展蓬勃，目前，共有超过200间从事微电子产业相关的公司，黑芝麻智能落户香港，将产生更大的协同效应及技术交流。现时本港有五所大学的排名位列全球首100名，当中更有逾100名大学研究人员从事微电子领域研究，能为行业提供顶尖人才及专业知识，推动高端芯片及半导体的研发。



图一：科技园公司与黑芝麻智能签署合作备忘录，宣布在香港科学园内设立「黑芝麻智能香港科技创新研发中心」，携手推动香港的汽车芯片产业及微电子生态圈发展。



Page 4 of 6



图二：创新科技及工业局局长孙东教授表示，新能源及智能汽车企业将会加速本地技术创新和升级，吸引更多海内外的创科及研发人才来港，并协助提升本地人才的技能和科技积累。



图三：香港科技园公司行政总裁黄克强先生表示，科技园公司将与黑芝麻智能携手推动香港高端芯片产业发展，同时和其他公司、大学和科研机构紧密交流，培育及吸纳更多微电子专才。



图四：黑芝麻智能科技有限公司创始人兼行政总裁单记章先生表示，黑芝麻智能将与科技园公司共同为实现香港创新科技的目标提供助力，为中国智能汽车产业的发展做出贡献。

###

关于香港科技园公司

香港科技园公司（科技园公司）于 2001 年成立，致力将香港发展成为国际创新科技中心。科技园公司在香港建立了蓬勃的创科生态圈，支持共超过 10 间独角兽企业，汇聚 13,000 多名研究人才，以及逾 1,400 间来自 24 个国家和地区从事生物医药技术、人工智能及机械人技术、金融科技及智慧城市发展的科技公司。

科技园公司一直大力吸纳及孕育创科人才、加速创科成果商品化，为科技企业及人才在创科路上提供全方位支持。我们建立的创科生态圈持续成长，足迹遍及全港，包括沙田的香港科学园、九龙塘的创新中心，以及位于大埔、将军澳及元朗的创新园。三个创新园结合创新元素，朝着香港新型工业化发展方向，重点带动先进制造业、微电子业及生物科技等行业，重新定位新世代工业。

为配合香港未来发展及持续增长的创科需求，科技园公司积极连系深港两地，加强跨境交流，支持全球科技企业及人才「引进来、走出去」，开拓内地、进军海外市场。位于深圳福田的香港科学园深圳分园已于今年 9 月开幕，园区总建筑面积为 31,000 平方米，两幢大楼设有干/湿实验室、共享工作位置、会议及展览场地等，务求提供更多科研及协作空间。科技园公司将重



黑芝麻智能
BLACK SESAME
TECHNOLOGIES



Page 6 of 6

点吸引来自医疗科技、大数据及人工智能、机械人技术、新材料、微电子、金融科技和可持续发展七大领域的企业。

科技园公司透过提供基础设施、支持服务、专业知识及合作伙伴网络，致力令创新科技成为香港的新经济动力，巩固香港国际创新科技中心的地位，同时借助位处大湾区核心的优势，成为引领创科发展的重要引擎。

更多有关香港科技园公司的详情，请浏览 www.hkstp.org。

关于黑芝麻智能科技有限公司

黑芝麻智能科技有限公司是领先的车规级智能汽车计算芯片及基于芯片的解决方案供货商，成立于 2016 年。公司从用于自动驾驶的华山系列高算力芯片开始，最近推出了武当系列跨域计算芯片，以满足对智能汽车先进功能的更多样化及复杂需求。公司自有的车规级产品及技术为智能汽车配备关键任务能力，包括自动驾驶、智能座舱、先进成像及互联等。通过由公司自行研发的 IP 核、算法和支持软件驱动的 SoC 和基于 SoC 的解决方案，提供全栈式自动驾驶能力以满足客户的广泛需求。

传媒查询，请联络：

香港科技园公司

马碧茹

电话：+852 2629 7032

电邮：claire.ma@hkstp.org

黑芝麻智能科技有限公司

黄莹

电话：+86 15002120548

电邮：hanna.huang@bst.ai

爱德曼国际公关公司

梁爽爽

电话：+852 2837 4775 / 9684 9460

电邮：Sonia.Leung@edelman.com /

Edelmanhkstppr@edelman.com